DERWENT-ACC-NO: 1988-011448

DERWENT-WEEK: 198802

COPYRIGHT 1999 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE: Resin compsn. used for prepreg prepn. - contg.

cyanate ester,

bis-maleimid e, polyether sulphone and epoxy! resin contg.

bisphenol f or a

PATENT-ASSIGNEE: TORAY IND INC[TORA]

PRIORITY-DATA: 1986JP-0117532 (May 23, 1986)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO PUB-DATE LANGUAGE

PAGES MAIN-IPC

JP 62275123 A November 30, 1987 , N/A

007 N/A

APPLICATION-DATA:

PUB-NO APPL-DESCRIPTOR APPL-NO

APPL-DATE

JP62275123A N/A 1986JP-0117532

May 23, 1986

INT-CL (IPC): C08G059/40; C08J005/24; C08L063/00

ABSTRACTED-PUB-NO: JP62275123A

BASIC-ABSTRACT: A resin compsn. for preparing prepreg with

reinforcing fibre

comprises (A) a cyanate ester, (B) bismaleimide in amts. of

(A) + (B) = 10-90

wt.% and (A)/(B) = 70/30 - 100/0, (C) 5-30 wt.% of

polyether sulphone and (D)

10-90 wt.% of epoxy resin comprising bisphenol F- or

A-type. Pref. (A) is of

formula R(O-CN)m (I): (R is aromatic gp. and m is 2 -5)

(e.g. 1,3- or

1,4-dicyanatobenzene, 1,3,5-tricyanatonaphthalene.

1,3,6-tricyanatonaphthalene, 4,4-dicyanatobiphenyl,

bis(4-cyanatophenyl)-b is

(4-cyanato phenyl) or 2,2-bis(3,5-dichloro-4-

cyanatophenyl) - propane, etc.).

(B) is prepd. by reacting an aromatic or aliphatic amine

with maleic anhydride

06/20/2002, EAST Version: 1.03.0002

and dehydrating and cyclising the formed maleinamidate salt. It is pref. bis(4-maleimide-phenyl)methane. (C) comprises repeating unit of formula (II). (D) comprises epoxy resin of bisphenol-F or -A-type and opt. epoxy resin or phenol novolak-, cresol novolak- or tetraglycidylaminodiphenyl methane-type, triglycidyl-p- or -m-aminophenyl etc. for improving the adhesion with the reinforcing fibre. The compsn. is prepd. by pulverising polyether sulphone, dissolving it in epoxy resin heated at 120-160 deg. C, cooling the soln. to lower than 100 deg. C and mixing the soln. with a mixt. of cyanate ester and bismaleimide prepolymerised at 80-140 deg. C in the presence of pulverised polyether sulphone dissolved in the epoxy resin and mixing the cooled prepolymer with the residual amt. of epoxy resin. compsn. is hardened opt. in the presence of a hardening catalyst (e.g. imidazole, phenol, Zn octylate, dicumyl peroxide, acid anhydride or azo cpd.). reinforcing fibre is pref. of carbon, aramide, alumina, Si- or W-carbide, or boron. USE/ADVANTAGE - The prepreg, has high storage stability and provides hardened prod. with high resistance to heat, water and impact. CHOSEN-DRAWING: Dwg.0/0 TITLE-TERMS: RESIN COMPOSITION PREPREG PREPARATION CONTAIN CYANATE ESTER DI MALEIMIDE POLYETHER SULPHONE POLYEPOXIDE RESIN CONTAIN BISPHENOL DERWENT-CLASS: A26 A32 CPI-CODES: A05-A02; A05-H07; A05-J05; A05-J06; A07-A03; A07-A03B; A07-A03C; A08-R01; UNLINKED-DERWENT-REGISTRY-NUMBERS: 0476U; 0868U; 1193U; 1247U ; 1544U ; 1668U

1 . . f

; 5023U ; 5086U

```
POLYMER-MULTIPUNCH-CODES-AND-KEY-SERIALS:
Key Serials: 0011 0016 0020 0034 0035 0203 0205 0218 0222
0069 0171 0183 0226
1218 1279 1282 3183 3184 1283 1309 1311 1357 1359 1373 3079
3083 1601 1920 2002
2020 2198 2212 2213 2215 2219 2285 2287 2288 2293 2299 2300
2301 2302 2307 2329
2330 2491 2493 2542 3251 2572 2600 2617 2628 3252 3255
Multipunch Codes: 014 02& 040 05- 06- 08& 08- 10- 106 134
140 141 147 15- 151
153 163 199 20- 213 214 215 216 220 221 222 225 226 229 23&
231 240 265 266 267
273 299 303 308 309 311 331 335 336 341 359 368 392 393 400
427 46& 473 479 48-
53& 532 533 535 536 54& 540 541 546 55& 551 556 560 566 57&
597 600 684 720 722
723 726
SECONDARY-ACC-NO:
CPI Secondary Accession Numbers: C1988-005167
```

06/20/2002, EAST Version: 1.03.0002

19 日本国特許庁(JP).

⑪特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭62 - 275123

⑤lnt Cl.* 識別記号 庁内整理番号 ④公開 昭和62年(1987)11月30日 C 08 G 59/40 NJE A-6561-4J B-6561-4J C 08 L 63/00 CFC 7206-4F 審査請求 未請求 発明の数 1 (全7頁)

図発明の名称 プリプレグ用樹脂組成物

②特 願 昭61-117532

20出 願 昭61(1986)5月23日

大津市園山1丁目1番1号 東レ株式会社滋賀事業場内 茂 江 ⑫発 明 者 鈴 大津市園山1丁目1番1号 東レ株式会社滋賀事業場内 見 茂 ⑫発 明 者 蓮 大津市園山1丁目1番1号 東レ株式会社滋賀事業場内 夫 村 木 者 79発 明 東京都中央区日本橋室町2丁目2番地 東レ株式会社 願 人 创出

明和谐

1. 発明の名称

プリプレグ用樹脂組成物

2. 特許請求の範囲

問胎成分 [A]、 [B]、 [C]、 [D]が、下記の重量分率を満たし、樹脂成分 [D]の主成分がピスフェノールド型エポキシ樹脂またはピスフェノールA型エポキシ樹脂であることを特徴とするプリプレグ用樹脂組成物。

[A]: シアン酸エステル

[3]: ヒスマレイミド

[C]: ポリエーテルスルホン

[D]: エポキシ樹脂

ここで、

[A]+[B]:10~90重量%

[C] : 5~30重量%

[D] : 10~90 M M %

ただし、重量比で次の関係を満たす。

 $[A] / [B] = 70/30 \sim 100/0$

3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

木発明は、先進複合材料として、強度、弾性率、さらにはこれらを比重で除した、比強度、比弾性率の大なることを要求される構造体に用いられるプリプレグに用いる個胎組成物に関する。さらに詳しくは、特に耐熱性と耐水性と耐衝撃性に優れ、航空機構造体として実際に使用される環境で高性能を発揮する、プリプレグ用マトリックス樹脂組成物に関する。

[従来の技術]

繊維強化プラスチックは、強化繊維とマトリックス間間からなる不均一材料であり、一般に強化 機能に関間を含没させたプリプレグが中間材料と して使用されている。プリプレグ用マトリックス 間間としては、プリブレグの積層を容易にするため がら使用されている。マトリックス間間は、強来 から使用されている。マトリックス間間は、強化 繊維の機械的性能を複合材料の構造体として発現 させるために重要な役割を担っており、特に、耐

特開昭62-275123 (2)

熱性、耐水性、耐溶剤性、非繊維軸方向の機械的 強度といった物性は、マトリックス樹脂の物性を、 顕著に反映する。 従来から、特に耐熱性を要求さ れる構造体は、テトラグリシジルジアミノジフェ ニルメタンと、ジアミノジフェニルスルホンを主 成分とするエポキシ倒脂が用いられてきているが、 近年、エポキシ樹脂よりも耐熱性及び耐水性の良 好な樹脂として、シアン酸エステル系樹脂が注目 されている。シアン酸エステル系樹脂はダイマー 酸系ポリアミド (特開昭58-198563) や 然可塑性ポリウレタンや熱可塑性かつ非晶性のポ リエステル (特開昭60-233175) と変性 して接着剤とすることが知られており、またポリ エーテルスルホンと混合した組成物(特開昭57 - 165451) も報告されている。また、この 樹脂にエポキシ樹脂とポリスルホン樹脂を混合し てプリプレグ用樹脂組成物 (特開昭60-250 026)とする例も知られている。

他方、耐熱性の良好なエポキシ樹脂系であるテ トラグリシシルシアミノシフェニルメタンとシア

の良好な樹脂組成を得るべく詳細に検討した結果、木発明に示される組成領域においてプリプレグ用 樹脂組成物として極めて有用であることを見い出 し、ここに提供するものである。本発明における プリプレグは特に高温条件下かつ吸水条件下とい った苛酷な暴露条件において高性能を発揮する。

[問題点を解決するための手段]

国胎成分 [A]、 [B]、 [C]、 [D]が、下記の重量分率を満たし、樹胎成分 [D]の主成分がピスフェノールド型エポキシ樹脂またはピスフェノール A型エポキシ樹脂であることを特徴とするプリプレグ用樹脂組成物である。

[Λ]: シアン酸エステル

[B]: ヒスマレイミド

[C]: ボリエーテルスルホン

[D]: エポキシ樹脂

ここで、

[A] + [B] : 10~90 瓜鼠%

[C] : 5~30 IL 11 %

[1)] :10~90瓜瓜%

ミノジフェニルスルホンを主成分とするエポキシ 樹脂系はポリエーテルスルホンをはじめとする熱 可塑性樹脂をプレンドすることで耐衝撃性を改替 することが検討されている。(特開昭 5 8 - 1 3 4 1 2 6)

シアン酸エステル系樹脂とエポキシ樹脂は、耐然性と耐水性で前者が勝り、靱性およびモノマーの種類が多いことによる配合の自由度において後者が勝っている。そこで、特開昭60-250026のようにこの両者の中間に位置する配合物が 提案されている。

[発明が解決しようとする問題点]

しかしながら、本発明での検討結果によると、特別昭60-250026で実際に提案された手法、すなわち、テトラグリシジルジアミノジフェニルメタンとジアミノジフェニルスルホンとシアン酸エステル系樹脂の4番の混合物では、ブリブレグとしての保存性が着しく悪いことが判明し、本発明者らはブリブグの保存性を確保しつつ耐熱性、耐水性、耐衝撃性

ただし、瓜肌比で次の関係を満たす。 [A]/[B]=70/30~100/0

本発明に用いる [A] 成分はシアン酸エステルであり、構造式 [1] の化合物である。

R ←O − C ≡ N) m 構造式 [l]

ここで、Rは芳香族性の有機基であり、mは2から5までの自然数である。

具体的に例示すれば、1,3-または1,4-ジシアナートベンゼン、1,3,5-トリシアナートベンゼン、1,3-、1,4-、1,6-、1,8-、2,6-、または2,7-ジシアナートナフタレン、1,3,6-トリシアナートナフタレン、4,4-ジアナートフェニル)メタン、2,2-ビス(4-ジアナートフェニル)プロバン、2,2-ビズ(3,5-ジプロームージアナートフェニル)プロバン、2,2-ビス(3,5-ジプロモー4-ジアナートフェニル)プロバン、ビス

(4-シアナートフェニル) エーテル、ビス (4 ーシアナートフェニル) チオエーテル、ビス (4 ーシアナートフェニルスルホン、トリス (4-シ アナートフェニル) ホスフェイト、トリス (4-シ シアナートフェニル) ホスフェート、および、 ポラックとハロゲン化シアンとの反応により得ら れるシアン酸エステルなどである。特に好適なシ アン酸エステルとしては2,2'ービス (4-シ アナトフェニル) プロバンがあげられる。

水発明に用いる [B] 成分は、ピスマレイミドである。ピスマレイミドとしては、構造式 [2] のものが用いられる。

排造式 [2]

ただしRは2価ないし5価の芳香族性または脂肪族性の有機基であり、mは2ないし5の自然数である。

キシ樹脂やシアン酸エステル系樹脂といった熱硬 化性樹脂に溶解させることが可能である。ポリエ - テルスルホンをテトラグリシジルジアミノジフ ェニルメタンとジアミノジフェニルスルホンから なるエポキシ樹脂系混合することは、特開昭58 - 134126で検討されたほか、パックナルら (C.B.Bucknall et al) , ポリマー (Polymer) , 24 699 (1983) や デイアマントら (J.Diamant et al) , 第29 回ナショナルサンペシンポジウ ム (29th National SAMPE Symp.) ,422 (1984)の 報文に見ることができる。 これらによると、樹 脂物性を表すKic値には、さしたる効果は見られ ていない。また、この系はテトラグリシジルジア ミノジフェニルメタンとジアミノジフェニルスル ホンに特有の、吸水性が大きいという欠点を有す るため、実際の桑蕗条件に相当する吸湿条件下か つ高温条件下での物性が、乾燥条件下かつ窒温条 作下での物性と比較して大きく低下するという欠 点を有する。

本発明において、必須成分として用いられるエ

これらのマレイミドは芳香族または脂肪族アミンと無水マレイン酸を反応させ、マレアミド酸を合成し、次いでマレアミド酸を脱水環化させることで製造される。特に好適なマレイミドとしては、ピス(4ーマレイミドフェニル)メタンかあげられる。

[A] 成分と [B] 成分は全樹脂中に合計で10~90 重量%、より好ましくは20~80 重量% 公まれる。これより少ないと樹脂の耐熱性や耐水性が悪くなる。これより多いと樹脂の靱性が不足する。

水苑明で川いるボリエーテルスルホンは、構造 式[3]の構造を有する耐熱性の良好な熱可塑性 樹脂である。

構造式 [3]

また、ポリエーテルスルホンはこの末端修飾物も別いられる。

ポリエーテルスルホンは適当な手段によりエポ

ポキシ樹脂は、ピスフェノールF型エポキシ樹脂 または、ピスフェノールA型エポキシ樹脂である。 特にピスフェノールド型エポキシ樹脂は粘度が低 くポリエーテルスルホンを多型に溶肝させること か可能であるため最も適している。これらのエポ キシ樹脂と混合して好ましく用いられるエポキシ 樹脂としては、フェノールノポラック型エポキシ 樹脂、クレゾールノボラック型エポキシ樹脂、テ トラグリシジルジアミノジフェニルメタン、トリ グリシジルーローアミノフェノール、トリグリシ ジル-m-アミノフェノール、プロム化エポキシ 樹脂、脂類式エボキシ樹脂等があげられる。また、 低分子量タイプのフェノールノポラック型エポキ シ樹脂は耐水性が良好なため好んで用いられる。 また、テトラグリシジルジアミノジフェニルメタ ンは耐熱性が良好で、強化繊維との接着性が良好 なため好んで用いられる。また、トリグリシジル - n - アミノフェノール、トリグリシジルーm -アミノフェノールは、強化繊維との接着性が良い ので好んで川いられる。

関られた組成領域において良好な物性が得られる ことを見出した.

すなわち、本発明における組成物は次の重量関 係を満たす。

[A]: シアン酸エステル

ピスマレイミド (B):

[C]: ポリエーテルスルホン

[D]: エポキシ樹脂

ここで、

[A] + [B] : 10~90重量%

[C]: 5~30重量%

:10~90重量% [D]

ただし、重量比で次の関係を満たす。

 $[A] / [B] = 70/30 \sim 100/0$ シアン酸エステルはピスマレイミドやエポキシ 樹脂と反応しまたシアン酸エステル同士でも反応 し硬化する。このとき、エポキシ樹脂、シアン酸 エステル、ピスマレイミド、の類に反応がしやす い。そのため、ピスマレイミドが多いとピスマレ

下させるため本発明の組成物に含まないことが好 ましい.

本発明における樹脂組成物の製法は例えば、ボ リエーテルスルホンを粉砕し120~160℃に 加熱したエポキシ樹脂に溶解させたのち100℃ 以下に冷却し、あらかじめ80~140℃で1~ 6 時間予備重合したシアン酸エステルとピスマレ イミドの混合物と混合して得られる。または、シ アン酸エステルとピスマレイミドを80~140 ℃で予備重合する時に粉砕したポリエーテルスル ホンを加えて溶解を同時に行い、100℃以下に **冷却ののちエポキシ樹脂を加える方法も用いられ** る。もちろん、ピスマレイミドを全く用いなくと - も同様の操作が可能である。これら製法において はポリエーテルスルホンを衝撃式粉砕機により粉 砕したのち後粉末として用いることが品位の高い 樹脂組成物を得るために肝要である。

本発明の組成物は加熱により無触媒で硬化が可 能であるが、硬化を促進させるための触媒として 用いられる化合物としては、イミダゾール類、フ

本発明においてはこれらの成分を特別に吟味し、 イミドか反応されずに残るため目胎の報性を低下 させる。そこで、シアン酸エステル [A] とピス マレイミド【B】の比率は、

> $[\Lambda] / [B] = 70/30 \sim 100/0$ とすることが必要である。他方、エポキシ問胎は シアン酸エステルより靱性に優れ、また、ポリエ -テルスルホンとの親和性が良いため10~90 **重量%、好ましくは20~80重量%用いられる。** これより多いとシアン酸エステルが相対的に少な くなりすぎるため硬化が不十分となり耐熱性が低 下する。これより少ないと樹脂の靱性が不足する。 また、ポリエーテルスルホンは樹脂全体の5~3 0 重量%、好ましくは10~25 重量%だけ含ま れる。ポリエーテルスルホンが少ないと目脂製性 か不足し多すぎると樹脂組成物の精着性(タック) が失われる。以上の理由により上述の組成が必須 となる。さらに、一般にエポキシ樹脂の硬化剤と して用いられる、ジアミノジフェニルスルホン等 の芳香族アミン類はシアン酸エステルとの反応性 が大きすぎるためプリプレグの保存性を苦しく低

エノール類、オクチル酸亜鉛等の有機金属塩、ジ クミルバーオキシド節の過酸化物、酸無水物、ア ゾ化合物が、あげられる。

本発明のプリプレグ用樹脂組成物と組合わせて 川いる強化繊維は、炭素繊維、アラミド繊維、ア ルミナ繊維、炭化ケイ紫繊維、タングステンカー パイド繊維、ボロン繊維等であるが、これらを併 用することも可能でありこれらの形状には限定さ

以降は実施例によりさらに詳しく本発明を説明 する.

[实施例]

実施例1~8および、比較例1~5

本作においては、強化繊維を含まないで国胎組 成物を硬化させた場合と、炭素繊維プリプレグを 作成して、成形しコンポジットとした場合の物性 を測定した。また樹脂の反応性は、その昇温時の 発熱拳動をDSC(示差走査熱量計)により測定 し評価した。また、硬化する以前の樹脂配合物の 枯着性を判定した。

表1に、樹脂組成を一括してまとめ、表2には、 漁化繊維を含まない樹脂硬化物の物性と樹脂の反 応性とCFRP物性を一括してまとめた。以降は、 実施例1~10、比較例1~5といった呼称によ り、表1に示す樹脂組成を表現することとする。

. . . .

また、DSCの昇温過程におけるガラス転移温度(Tg)を、また、40時間源水浸漬における 重量増加率により、吸水率を求めた。また、硬化 以前の樹脂配合物のタックを判定してこれらの結 果を表2に示した。

樹脂の反応性は樹脂組成物をDSCの昇温過程における発熱開始温度を求めることにより評価した。

さらにこれらの樹脂組成物を用いて一方向 C F プリプレグを作製し、成型してその C F R P 物性 強化繊維を含まない協脂硬化物の物性は、次の 様にして測定した。

(方法)

表1に示されるエポキシ樹脂とポリエーテルス ルホンを、所定量だけ九底ビーカーに秤畳し、1 60℃のオイルパスにて加熱し均一混合させる。

を測定した。

(ガ法)

ニーダーを用いて母脂を調合した。例えば、実施例1の場合ニーダーを150℃に加熱し、4.5 KgのEPC830と予め衝撃式粉砕機により微粉末状に粉砕した2.1 Kgのポリエーテルスルルンを2時間混合溶解させる。完全溶解したことは位相差顕微鏡による観察により確認した。その後ニーダーを60℃に冷却し、あらかじめ予備エーダーを60℃に冷却し、あらかじめ予備でした5.5 Kgの2、2'ーピス(4ーシアナトフェニルブロバン)を添加してそのまま1時間提件混合した。

健型紙にこの樹脂を押広げ、一方向に引き揃えたトレカT-800(東レ(株)商標)と圧着することによりプリプレグを作製した。成形後の繊維の体積含有率か60%となるように樹脂の厚さを調節した。

得られたプリプレグを疑似等方的に 4 8 枚 積 形 してオートクレープ中で 6 kg f / mm² の圧力下で 1 8 0 ℃ 2 時間の成形を行い C F R P を得た。この 物の厚さは6、8mmであった。

このCFRPを高さ25cm、幅125mmに切断した。この試験片をNASA Reference Pubrication 1092 (1983)に従って、[1] 有孔板圧縮試験、[2] 衝撃後圧縮試験に用いた。これらは飽和吸水の70%に遂するまで90℃の水中に没頭し121℃の恒温槽中で強度試験を行った。

[1] 有孔板圧縮試験は試験片の中央に2.5 cmの穴をドリルであけた。結果は表2にOHC (HW) として表示した。

[2] 衝撃後圧縮試験は試験片の中央に落鍾試験により1000ポンドインチ/インチの衝撃を与えた。結果は表2にCAI(HW)として表示した。

実施例 1 ~ 5 は B / T = 0 / 1 0 0 の 問 胎 、 B / T = 2 0 / 8 0 の 樹 胎 、 E P C 8 3 0 、 E P 8 2 8 を 成 分 と し 、 樹 脂 硬 化 物 物 性 が 何 れ も 良 好 で あった。 引 張 り 伸 度 が 高 い こ と は C F R P が 衝 撃 時 に 受 け る 損 傷 を 小 さ く す る こ と に 寄 与 す る 。 ま た 、 吸 水 高 温 下 で の 弾 性 率 が 大 き い こ と は 、 そ の

いないことが望ましい。比較例3はB/T=50 :50の樹脂を用いた例であるが引張仲度が低く、 乾燥品の室温での弾性率が高い割りに吸水品の高 温下での弾性率の低下が大きく本発明の目的に適 さないことがわかる。そこで、本発明においては シアン酸エステル/ピスマレイミド=70/30 ~100/0が適当であることがわかる。比較例 4 はポリエーテルスルホンの含量を少なくしたも のであるが、引張伸度が低下し損傷後の圧縮強度 か低く木発明に適さない。比較例5はポリエーテ ルスルホンの含量を増やしたが、樹脂配合物のタ ックがないため本発明に適さない。そこで、ポリ エーテルスルホンの含量は5~30m量%である ことが必要である。また、樹脂の引張仲度を高め るために、エポキシ樹脂は全体の10~90重量 %含まれる。以上のようにCFRP用マトリック ス樹脂に要求される樹脂物性の項目が多岐にわた りかつ難しいため良好な組成がおのずと限定され、 本発明により開示された組成が吸水条件下かつ高 温下という苛酷な環境においてとりわけ優れてい

条件下でのCFRPの圧縮強度を高めることに寄与し、その弾性率は、窒温における弾性率やTgや吸水率に依存すると考えられる。そのためOHC(HW)とCAI(HW)の両方を高めるためには、表2に示した樹脂硬化物物性のいずれもが良好である必要がある。その点で、特に実施例1は優れている。実施例6、7はELM434、ELM120を川い、実施例8ではB/T=20:80の樹脂を川いたが実施例1ほど良好ではなかった。ピスマレイミドの含量を増やすと吸水品の高温下での弾性率が低下することがこれにより理解できる。

比較例ではDDSを使用した例であるが、反応開始温度が低くプリプレグとしての保存性に問題があることがわかった。比較例2は特開昭60-250026に見られる組成と類似しているが、比較例1よりさらに反応開始温度が低くプリプレグとしての保存性に著しく問題があることがわかった。そのため、本発明の組成物にはシアミノは用フェニルスルホンをはじめする芳香族アミンは用

ることが明らかとなった。

特許出願人 亚レ株式会社

表 1 樹 脂 組 成

		衣!	(2)	l Bã		נת ו	Ų,					
								上段:				
		実	觤		例				比	較	(5)	
1	2	3	4					1			4	5
,	40		0		0	0	. 0		0	0	- 1	55
(46)	(33)	(60)		(47)								(38)
0	0	0		0			-	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0		· •		0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
	1	1		0]					0		- 1	45
												(31)
0	0	. 0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0		0	0			0	0	0
0	0	0	0	0	0		•	0	0	0	0	0
- 1									· 1	1	- 1	45
				(14)	(14)	(14)	(14)					(31)
0	. 0	0.02	0.02					0	0.02	0.02	0.02	0.02
0	0	0	0.1	0.1	0.1	0.1	· 0. 1	0	0.1	0.1	0.1	0.1
							- • •					
0	0	0	0	0	0	0	0	10		0	0	0
								(8)	(16)			
	55 (46) 0 0 0 0 45 (37) 0 0 21 (17) 0	55 40 (46) (33) 0 0 0 0 0 0 0 0 45 60 (37) (50) 0 0 0 0 21 21 (17) (17) 0 0	大 1 2 3 55 40 70 (46) (33) (60) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 60 60 (37) (50) (50) 0 0 0 0 0 0 0 0 21 21 21 21 (17) (17) (17) 0 0 0.02	大阪 大阪 大阪 大阪 大阪 大阪 大阪 大阪	大き がを	実施 施 例 1 2 3 4 5 6 55 40 70 0 55 0 (46) (33) (60) (47) 0 0 0 0 70 0 55 (60) (60) (47) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 60 60 30 0 30 (37) (50) (50) (26) (26) 0 0 0 0 45 0 (39) 0 (39) 0 15 (13) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 21 21 16 16 16 (17) (17) (17) (14) (14) (14) 0 0	実 施 例 1 2 3 4 5 6 7 55 40 70 0 55 0 0 0 0 0 70 0 55 50 (60) (47) (43) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 60 60 30 0 30 30 (26) (26) (26) (37) (50) (50) (26)	大阪 大阪 大阪 大阪 大阪 大阪 大阪 大阪	上段: 大阪 大阪 大阪 大阪 大阪 大阪 大阪 大	上段:重量部	上段: 重量部 下段	上段:重量部 下段() 内

表2 強化しない樹脂およびCFRP物性

	項 目	実		. th	恒 例。				比		較		例	
		1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5
	引張強度 (kgf/mm²)	11.1	9.6	11.7	9. 7	11.0	9.7	9.8	9.4	-	_	8.1	10.0	-
硬	引張弾性率(kgf/mm²)	377	396	393	393	361	403	401	398	_		420	380	_
化	引張仲度 (%)	5.9	3.3	4.0	3.6	5.2	3.3	3.6	3.1	-	_	3.0	4.1	_
物物	吸水品 121℃での 曲げ弾性率(kgf/mm²)	283	249	253	281	270	274	275	251	_	· -	241	281	_
性	吸水率 (%)	1.7	1.7	2.1	2.1	1.8	2.3	2.3	2.1	_	-	2.1	2.1	-
	Tg (℃)	204	185	210	206	208	206	201	211	_	1	215	203	_
	 樹脂配合物のタック	0	0	0	0	0	0	0	0	×	0	×	0	XX
樹眉	発熱開始温度(℃)	128	132	121	131	126	117	119	135	90	78	152	128	-
樹脂反心性 CFXP物性	反応性の評価	0	0	0	0	0	0	0	0	×	XX	0	0	
CFR	OHC(HW) (kgf/mm²)	22.3	_	21.7	22.1	_	21.5	22.3	22.2	_	18.2	-	22.5	_
户地性	CAI(HW) (kgf/mm²)	21.5	_	20.0	20.2	_	14.2	14.6	13.7	_	14.6	_	12.0	